

Designempfehlung für Leiterplatten

Um eine prozesssichere und wirtschaftliche Prüflösung zu realisieren, ist es ratsam, bereits bei der Leiterplattenentwicklung folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Für die Positionierung der Leiterplatte auf dem Adapter sind zwei Bohrungen mit einem Durchmesser von 3,0mm (oder größer) vorhanden. Diese Bohrungen haben einen größtmöglichen Abstand zueinander sowie eine Lage- und Größentoleranz von +/- 0,05mm oder enger.
- Für eine Standardkontaktierung ohne zusätzliche Führung der Kontaktstifte haben die Testpads einen Durchmesser von 0,6 mm oder größer. Durch Führung der Kontaktstifte können Testpads ab 0,4 mm Durchmesser prozesssicher kontaktiert werden (Grundlage hierfür sind eine Lage- und Größentoleranz von Testpads und Fangbohrungen von +/- 0,05mm oder enger.)
- Das Raster (der Abstand von Testpunkt zu Testpunkt) beträgt 50 Mil (1,27 mm) oder größer, ab einem Raster von 75 Mil (1,91mm) kann eine Standardkontaktierung ohne zusätzliche Führung der Hülsen erfolgen.
- Um Beschädigungen an Bauteilen zu vermeiden haben Testpads mindestens 1 mm Abstand zu Bauteilen. Ab einer Bauteilhöhe von 5 mm habe Testpad mindestens 2 mm Abstand zu Bauteilen da es sonst zu Interferenzen von Ausfräsungen für Bauteile mit Testpunkten kommen kann bzw. Kontaktstifte beim Schließen des Adapters mit Bauteilen kollidieren.
- Für die Positionierung der Niederhaltestempel (Top) und Prüflingsauflagen (Bottom) stehen ausreichend Freiflächen ohne Bauteile und ohne Leiterbahnen zur Verfügung.

Sollten einer der aufgeführten Punkt nicht erfüllt werden können muss im Detail geprüft werden ob eine prozesssichere Kontaktierung möglich ist. Nehmen Sie hierzu bitte Kontakt zu Ihrem technischen Ansprechpartner bei INGUN auf.

